

证券代码：300131 证券简称：英唐智控

深圳市英唐智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中信建投（朱君玲）、中信证券（钟镇松）、广发证券（安丽丽）、智富圈基金（李剑辉）、源益基金（张雷）、和合易泰基金（郭泓程、郝继东）、锦洋基金（邱凌苍）、金田基金（汪邯卿）、锦洋基金（徐景辉）、伟信振川投资（林丽娟）、德远投资（吕伟强）、恒邦兆丰（吴涛）、宁振妃、赵凡、陈醉、王钢、吴少慧 |
| 时间 | 2025年7月17日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、副总经理 李昊 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、基本情况介绍</p> <p>公司董事会秘书李昊先生为投资者简单介绍了英唐智控的发展历程，主营业务为电子元器件分销，半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造、销售，软件研发、销售及维护等业务。重点介绍了公司近两年来向上游半导体行业转型进展和产品的规划布局，展示了公司自研芯片产品MEMS微振镜、车载显示领域芯片DDIC和TDDI，并就几款产品的研发进度和量产情况做了介绍。</p> <p>二、提问交流环节</p> <p>1. MEMS微振镜是否有切入人形机器人领域？</p> <p>答：公司的MEMS微振镜可以应用于车载激光雷达、工业、机器人、无人机、医疗器械等领域，目前4mm规格的MEMS微振镜已率先进入批量生产阶段并将在工业机器人实现应用，其他领域客户目前已完成多家</p> |

客户送样。

2. 日本英唐微技术是否与英唐并表，业绩情况如何？

答：日本英唐微技术为本公司全资子公司，在并表范围内。日本英唐微技术专注于光电转换和图像处理的模拟IC和数字IC产品的研发生产，近几年持续为公司贡献利润，具体情况可查看公司披露的年度报告中“管理层讨论与分析”章节。

3. 公司在车载显示驱动芯片的客户情况？

答：公司车载DDIC/TDDI 的订单主要来自屏幕厂商，目前已交付至国内车企的8.4寸仪表屏项目、海外客户12.3寸的屏幕项目，并获得了境内外多家客户的屏幕项目定点和项目测试订单。

4. 英伟达H20放开对公司是否有影响？以及近期中美政策上对公司的影响？

答：公司当前业务布局中未涉及对美国的直接出口业务，亦不存在从美国进口原产地商品的相关贸易活动，因此，近期中美关税政策调整及反制措施的实施，不会对公司日常经营及财务状况产生直接影响，但英伟达H20的放开，一定程度上预示中美贸易环境正向宽松的方向转变。

5. 英唐研发人员以及研发投入的情况？

答：近年来，公司持续重点投入两大芯片研发项目，即显示驱动芯片与MEMS微振镜，2024年度公司研发投入9,944.85万元，较上年同比增长155.99%，报告期末公司研发人员合计201人，占公司总人数的31.85%。期间费用较上年同期有所下降，公司不断优化企业内部管理，降本增效初见成效。

6. 公司对于车规级的车载显示芯片市场占有率方面有什么期望？

答：根据Omdia汽车显示器情报服务的最新数据报告，2024年全球汽车显示器面板出货量达到2.32亿片，同比增长6.3%。目前国内车载显示驱动芯片的绝大部分市场被台湾、韩国厂商占据，公司将通过继续开发本土供应链体系，为公司建立更具有竞争力的产品体系，实现

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>市场份额的提升。</p> <p>7. 消费级的产品跟车规级的产品相比，车规级的技术壁垒主要体现在什么地方？</p> <p>答：相对比与消费级产品，车规级对于其可靠性、环境适应能力以及开发周期与成本方面有着更高的要求。车规级产品需在极端温度、高强度振动及化学腐蚀环境中稳定运行。此外车规级产品开发周期更长，研发复杂程度更高，单颗芯片成本更高，消费级产品追求性价比和快速迭代，而车规级产品则以安全第一为原则。这些要求共同构成车规级产品的综合技术壁垒。</p> <p>8. 控股股东近期与高新投做了非交易过户，具体情况是什么？</p> <p>答：具体情况请关注公司公告。</p> <p>9. 公司是否有并购计划？</p> <p>答：通过并购方式加速半导体业务推进，已纳入公司的重点工作计划。未来如果有合适的收并购机会，且符合公司的战略规划、能够与公司现有业务形成协同效应，公司将借助有利的政策、市场环境，认真地进行评估和考量。公司希望未来可以通过吸纳国内优秀人才资源，整合与公司在技术、市场方面高度协同的产业链，提升公司研发创新能力，把握发展机遇，提升股东价值。</p> <p>10. 公司分销代理的毛利率情况？</p> <p>答：公司分销业务板块毛利与市场整体趋势保持一致，产业链各参与主体的产品毛利均存在压缩。未来公司将持续通过业务集聚化与专业化，提升了分销业务的盈利水平。同时，公司芯片制造业务方面毛利率较往年同期有所增加。公司在稳固现有分销业务规模的同时，将加大芯片设计制造投入，力争3-5年内使该业务成为核心增长极，提升公司盈利能力。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p> |
| <p>附件清单（如有）</p> | |
| <p>日期</p> | <p>2025年07月18日</p> |